

证券代码：688603

证券简称：天承科技

## 广东天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	通过上证路演中心参与“2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”的投资者	
调研时间	2025年5月15日（周四）15:00-16:30	
会议地点	上证路演中心（网址： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）	
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：童茂军 董事会秘书、副总经理：费维 财务负责人：王晓花 独立董事：石建宾 首席技术官：韩佐晏	
投资者关系活动主要内容记录	<p>一、董事长童茂军先生致辞</p> <p>二、网络文字互动问答</p> <p>（一）公司本期整体业绩水平如何？</p> <p>答复：</p> <p>尊敬的投资者您好，报告期内，公司在持续强化市场拓展能力的同时，积极巩固现有市场优势，通过优化产品销售结构，不断提升高价值产品的销售占比，进一步夯实市场竞争力。同时，公司持续加大产品研发投入，专注于技术创新与突破，依托丰富的产品矩阵和全面的服务解决方案，有效满足多元化市场需求，为公司核心竞争力赋能。2024年，公司实现营业总收入38,067万元，同比增长12.32%；归属于母公司所有者的净利润7,467万元，同比增长27.50%。感谢您的</p>	

关注！

**（三）请问公司 2025 年的战略规划如何？**

答复：

尊敬的投资者您好，2025 年公司将以高质量发展为战略目标，全面提升经营管理水平，从多个维度提升企业竞争力：持续强化市场拓展能力的同时，通过提升高价值产品的销售占比，优化公司收益率；持续加大产品研发投入，专注于技术创新与突破，依托丰富的产品矩阵和全面的服务解决方案，有效满足多元化市场需求；深入推进精细化管理，通过优化资源配置、引入智能制造、强化成本控制，实现降本增效；积极布局海外市场，推动泰国工厂的建设进度，提升公司海外市场影响力；持续引入国内高端技术人才，将公司主体落户上海集成电路集中地并于浦东建立公司研发中心平台，积极优化现有核心产品并开发新配方，不断拓展半导体、显示面板、新能源等新领域的产品应用。

天承科技始终以自主研发为根本，抓紧产业升级和国际化的新机遇，不断探索前沿工艺的融合发展，持续创新提升核心竞争力，打破行业垄断并提供“进口替代”的新方案，力争成为专用功能性湿电子化学品领域的行业领军品牌。感谢您的关注！

**（三）PCB（印制电路板）专用化学品仍是核心业务，2024 年收入占比多少？**

答复：

尊敬的投资者您好，公司的主要业务为印制线路板、封装载板和半导体先进封装、显示面板等所需要的专用功能性湿电子化学品的研发、生产和销售。其中，2024 年公司印制线路板专用化学品的收入占主营业务收入的比例为 85%左右。感谢您的关注！

**（四）募投项目建设进度如何？2025 年产能预计提升多少？**

答复：

尊敬的投资者您好，公司募投项目“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”已完成建设，其主要用于半导体先进封装、先进制程所需要的功能性湿电子化学品的生产，年产能为

	<p>100 吨。此外，公司“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”因目前尚未取得“珠海研发中心建设项目”实施所需土地而延期，具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。感谢您的关注！</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2025 年 5 月 16 日